

AZ TFP® -600 SERIES PHOTORESIST

TFP is a registered trademark or trademark of AZ Electronic Materials.

フラットパネルディスプレイ製造用 高感度スピコート対応ポジ型レジスト

FPD製造、特にTFT製造に適した超高感度・高密着性を有したスピコート用ポジ型レジストです。安全溶媒であるPGMEAを使用し安全にご使用頂けます。

特徴

- 1) 超高感度・高残膜を有しスループットが大幅に向上します。
- 2) 様々な金属膜に対して現像時およびエッチング時に優れた密着性を有します。
- 3) 高密着と同時に優れた剥離性を有します。

一般的使用方法

プリベーク	: 100°C 90秒 (DHP)
露光	: FPD用ステッパー (g+h 線)
現像	: AZ 300MIF (2.38%) 23°C 60秒
リンス	: 超純水 30秒
ポストベーク	: 120°C 120秒 (DHP)
剥離	: 当社専用剥離液

製品と仕様 (PRODUCT RANGE)

Product Name	AZ TFP-650F5	AZ TFP-650H2
Viscosity	15mPa	15mPa

Photo-Sensitivity

	Eop	Remained Film Thickness
Conventional Resist	40mJ/cm ²	95%
AZ TFP-650F5	22mJ/cm ²	93%

Process Condition

Substrate	: Bare Si
Pre-bake	: 100°C 90sec. (DHP)
Film Thickness	: 1.5µm
Exposure	: NIKON FX604F (g+h line stepper)
Developing	: AZ300MIF (2.38%) 23°C 60sec.

Ultra High Sensitivity Spin Coating Positive-tone Photoresist For Flat Panel Display

Ultra High Sensitivity & High adhesion property positive resist, Optimized for FPD manufacturing, especially TFT manufacturing. The solvent is safe with PGMEA.

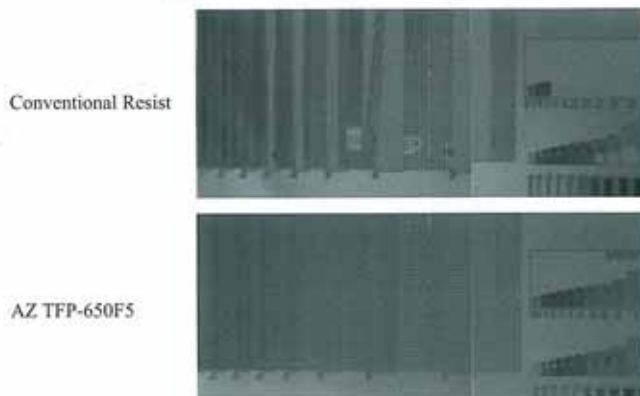
FEATURES

- 1) Improvement for throughput by high sensitivity & high dark erosion
- 2) Good adhesion property on various metal film at developing & Etching
- 3) Good adhesion & good stripping

SAMPLE PROCESS CONDITIONS

Pre-bake	: 100°C 90sec. (DHP)
Exposure	: FPD Stepper (g-line + h-line)
Developing	: AZ 300MIF (2.38%) 23°C 60sec.
Rinse	: DI-water 30sec.
Post-bake	: 120°C 120sec. (DHP)
Removing	: AZ Remover

Adhesion Property



Process Condition

Substrate	: SiNx
Pre-bake	: 100°C 90sec. (DHP)
Film Thickness	: 1.5µm
Exposure	: g-line stepper
Developing	: AZ300MIF (2.38%) 23°C 60sec.